

積體電路設計、封裝、測試(投資金額超過五千萬美元)申請計畫書架構

(關鍵技術小組審查用)

壹、計畫摘要

- 一、投資技術
- 二、投資方式
- 三、投資金額(資金籌措及運用)
- 四、僱用人數
- 五、國內相對投資計畫

貳、公司概况

- 一、基本資料(含持股結構)
- 二、台灣各廠產能現況、對應產品、員工僱用現況
- 三、營運及財務狀況
- 四、經營團隊
- 五、研發實績
- 六、全球布局現況
- 七、經營理念、策略及其他

參、計畫內容

- 一、審查對照表(依照審查原則製作對照表，廠商逐項自我檢核，並依序檢附相關佐證文件)
- 二、赴大陸投資因素
- 三、大陸投資規劃(大陸投資規劃，含技術、產能、時程、投資金額、員工僱用及台灣及大陸各廠製程、產能與時程對照示意圖等)
- 四、財務計畫(籌資規畫、資金運用及盈餘匯回規劃)
- 五、生產技術管理(使用技術層次、智財管理機制、技術報酬或權利金之計價)
- 六、產業帶動及經濟影響(產業上中下游帶動作法與效益)
- 七、全球與兩岸布局策略
- 八、未來承諾

肆、風險評估與智慧財產權保護規劃

- 一、政經風險分析
- 二、營運風險分析
- 三、技術來源及研發計畫
- 四、技術保護機制
- 五、退出機制

伍、獲利分析(未來五年獲利分析)

陸、其他

柒、總結

捌、附件清單